

科技部 函

地址：台北市和平東路二段106號
聯絡人：何幸蓉 助理研究員
電話：02-2737-7932
傳真：02-2737-7619
電子信箱：srhe@most.gov.tw

受文者：國立清華大學

發文日期：中華民國107年6月15日
發文字號：科部產字第1070040234號
密等及解密條件或保密期限：
附件：附件1 參展須知、附件2 技術摘要表(107TOP002492_107D2013996-01.docx、107TOP002492_107D2013997-01.doc)

主旨：「2018年台灣創新技術博覽會」訂於本（107）年9月27日（四）起至9月29日（六）假台北世貿展覽一館展出，請貴單位踴躍報名「創新發明館」參展事宜，請查照。

說明：

- 一、本展係原「台北國際發明暨技術交易展」，於今年轉型更名為「2018年台灣創新技術博覽會」。
- 二、為有效使學研機構的研發成果與產業結合，由科技部、教育部、國防部於旨揭展覽共同設置「創新發明館」，期望透過技術包裝展示與活動推廣，提升技術媒合交易之成效。
- 三、敬邀各學研機構報名參展，請貴單位以可交易之研發技術成果提出申請（詳參展須知，如附件1），本部將就符合參展規範之技術進行評選。凡入選「2018年台灣創新技術博覽會-創新發明館」主題情境展示區技術，將頒發獎金新台幣1萬元，以表揚入選技術團隊。
- 四、本館參展報名，自即日起至7月6日（五）開放線上報名，請於網路報名專頁填妥技術資料表（如附件2），網址為h



ttp://www.most.org.tw/。

五、本案聯絡窗口資訊如下：何幸蓉，電話：02-2737-7932，

E-mail：srhe@most.gov.tw。

正本：本部受補助單位（共303單位）

副本：教育部(含附件)

電子公文
2018-06-15
14:59:34
章

部長陳良基

裝



訂



線